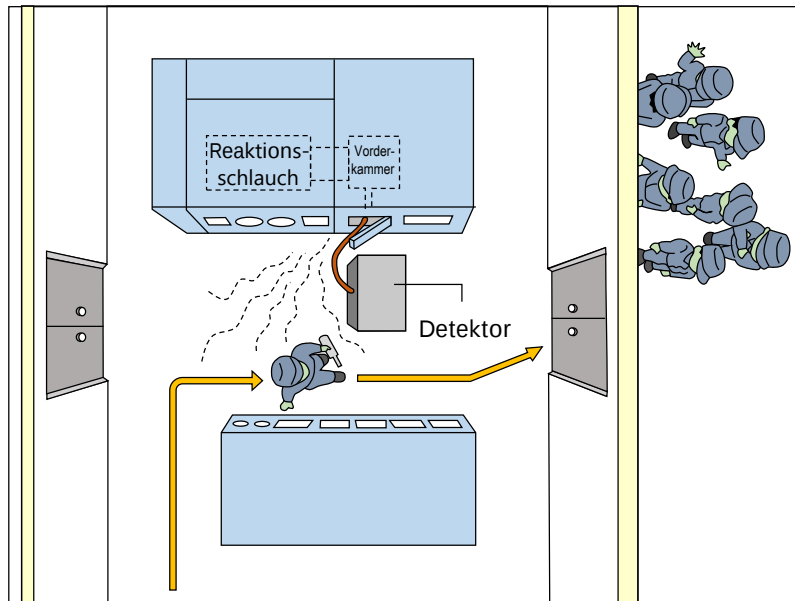


Fall einer Vergiftung bei der Wartung einer Halbleiterproduktionsanlage



[Ort des Unfalls]

Bei Wartungsarbeiten in einer Halbleiterproduktionsanlage

[Unfallursache]

Nach einer Beratung über den von einem Halbleiterhersteller durchzuführenden Backvorgang*¹ und Oxidationsvorgang*² für die Instandhaltung, kam es bei der Messung des in der Halbleiteranlage verbleibenden Gases zu einem Austritt von giftigen Gasen. Der Arbeiter der an dem System vorbeikam, erlitt eine Vergiftung.

- *¹ Backvorgang Verfahren, bei dem ein Reaktionsschlauch mit Wasserstoff aus einer Gasflasche gefüllt und die Temperatur erhöht wird, um giftige Gase aus dem System zu entfernen
- *² Oxidationsvorgang Verfahren, bei dem Sauerstoff und Stickstoff aus Gasflaschen eingeleitet werden, um mit den am Reaktionsrohr anhaftenden giftigen Stoffen zu reagieren und eine Oxidschicht zu bilden, um die Freisetzung von Schadstoffen, wie z. B. Phosphor, zu minimieren

[Schäden/Verletzungen]

Der Arbeiter ruhte sich etwa eine Stunde lang im Büro aus, suchte dann aber den Werksarzt auf, nachdem es sich weiterhin unwohl fühlte. Auf Anraten des Arztes wurde das Opfer in einer Universitätsklinik untersucht. Es wurde eine akute chemische Vergiftung diagnostiziert und der Arbeiter wurde vier Tage lang stationär behandelt.

Auszug aus [Vorbeugende Maßnahmen]

[1] Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, die das Erkennen von Schadstoffen ermöglichen, ohne die Tür der Anlage zu öffnen.



Riken Keiki Empfehlungen

Wir empfehlen den Einsatz von Gaswarngeräten, um die Konzentrationen in der Umgebung vor den Arbeiten zu überprüfen, sowie auf Lecks in der Umgebung zu achten und um zu bestätigen, dass anschließend wieder normale Bedingungen herrschen, wenn die Arbeiten schädliche Stoffe enthalten oder erzeugen können.